

1-8-4-10 はんだブリッジ短絡／焊料桥接的短路 / Short by solder bridge

【特徴】HALはんだで端子間がブリッジ状に繋がっている短絡

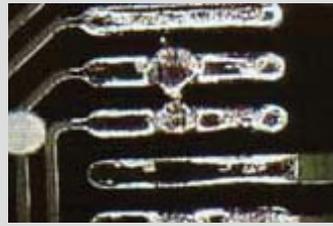
【特征】热风整平后在插脚之间有焊料桥接的短路。

【Characteristics】Edge board contacts are bridged with solder applied by HAL.

【原因・判断ポイント・発生工程】HAL装置の保全不良やはんだ組成異常等で出来たもの（HAL工程）

【原因、判断要点、发生工序】HAL装置の保全不良、或者焊料组成异常等而引起的（HAL工序）。

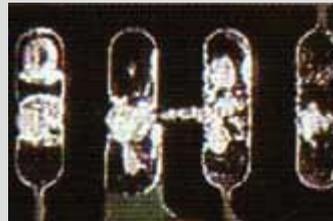
【Causes/processes involved/keys to judgment】This defect is caused by improper maintenance of an HAL apparatus or improper HAL solder composition (HAL process)



【コメント】顕微鏡倍率×20

【注釋】显微镜倍率×20

【Comments】Magnification: ×20



【コメント】顕微鏡倍率×20

【注釋】显微镜倍率×20

【Comments】Magnification: ×20

1-8-4-11 層間導電異物短絡／导电性杂物的层间短路 / Layer-to-layer short by a conductive foreign object

【特徴】基板樹脂部に紛れ込んだ導電性異物を介した層間短絡

【特征】在树脂层混入导电性杂物的层间短路。

【Characteristics】Layer-to-layer short by a conductive foreign object entrapped in base material

【原因・判断ポイント・発生工程】銅張積層板の樹脂部、樹脂付銅箔の樹脂部等に紛れ込んだ導電性異物により出来たもの（銅張積層板製造工程、樹脂付銅箔製造工程、多層板積層工程）

【原因、判断要点、发生工序】在覆铜板的树脂层、背胶铜箔的树脂层混入导电性杂物所引起的（覆铜板制作工序、背胶铜箔制作工序、多层板层压工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】The defect is caused by a conductive foreign object entrapped in the resin of a CCL or RCC (CCL or RCC manufacturing or multilayer lamination process)



【コメント】このような積層板を使用すると層間短絡する可能性がある
顕微鏡倍率×300

【注釋】如果使用这种层压板，往往会出现层间短路
显微镜倍率×300

【Comments】LSuch a base material may cause layer-to-layer short.
Magnification: ×300



【コメント】このような積層板を使用すると層間短絡する可能性がある
顕微鏡倍率×300

【注釋】如果使用这种层压板，往往会出现层间短路
显微镜倍率×300

【Comments】LSuch a base material may cause layer-to-layer short.
Magnification: ×300